

UNIVERSAL



PRIMER™

Vật Liệu Lưỡng Trùng Hợp



Rx Only



UNIVERSAL PRIMER™

Universal Primer là chất kết dính trùng hợp kép được thiết kế để sử dụng mà không cần quang trùng hợp lớp kết dính dưới các phục hình gián tiếp. Với thành phần hóa học dựa trên công nghệ All-Bond Universal® của BISCO, Universal Primer có thể được sử dụng với bất kỳ kỹ thuật khắc acid nào (tự khắc acid, khắc acid chọn lọc hoặc khắc acid toàn phần) và tương thích với xi măng nhựa quang trùng hợp, trùng hợp kép và tự trùng hợp, composite và vật liệu cùi giả cho các quy trình gắn kết trực tiếp và gián tiếp.

ĐẶC ĐIỂM & LỢI ÍCH



Trùng hợp kép:

Không cần quang trùng hợp khisử dụng cho phục hình gián tiếp.



Chứa Monomer MDP

Để tăng cường độ bám dính



Độ dày lớp màng thấp:

Dưới 5µm cho phép chất kết dính dễ dàng chảy vào bề mặt đã khắc acid.



Dễ sử dụng:

Đánh giá lâm sàng xác nhận tính dễ sử dụng, hầu như không có độ nhạy cảm sau phẫu thuật.



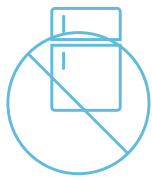
Tính linh hoạt:

Có thể được sử dụng với các kỹ thuật khắc acid toàn phần, tự khắc acid và khắc acid chọn lọc.



Tính tương thích:

Tương thích với xi măng nhựa quang trùng hợp, trùng hợp kép và tự trùng hợp, composite và vật liệu cùi giả cho các quy trình gắn kết trực tiếp và gián tiếp

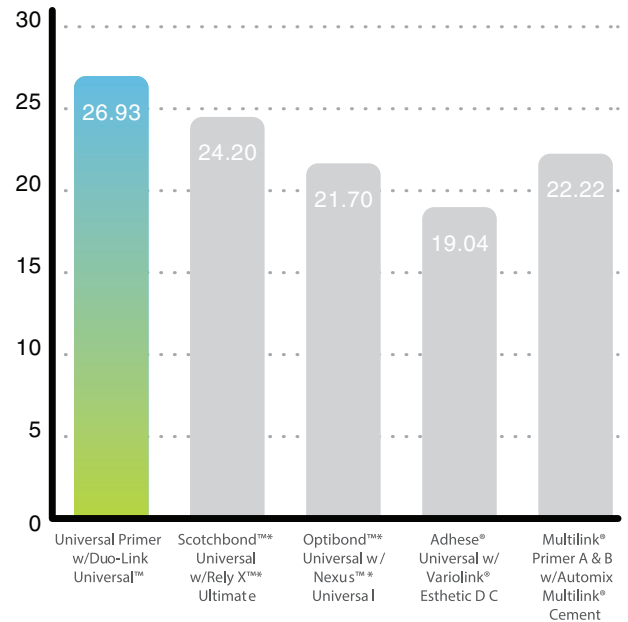


Không yêu cầu bảo quản lạnh.

BẠN CÓ BIẾT?

MDP là monomer chức năng, tăng cường độ bám dính có trong công thức của Universal Primer. Được chứng minh là mang lại sự ổn định đặc biệt trong liên kết hóa học theo thời gian, MDP cũng cho phép Universal Primer liên kết với zirconia và các chất nền kim loại khác, cũng như composite và xi măng nhựa trên thị trường. Universal Primer có thể được sử dụng thành công ở chế độ tự khắc acid, khắc acid toàn phần và khắc acid chọn lọc.

Lực liên kết cắt trượt với ngà răng ở chế độ tự trùng hợp (MPa)



Cả chất dán (adhesive) và xi măng đều được tự trùng hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
*Nhân hiệu là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Lực liên kết cắt trượt với các chất nền khác nhau (Duo-Link Universal)†

CHẤT NỀN	UNIVERSAL PRIMER (MPa)
Men răng cắt (Khắc acid chọn lọc/toàn phần)	25.14 / 31.53
Ngà răng (Khắc acid chọn lọc/toàn phần)	26.78 / 32.47
Lithium Disilicate (xử lý silane)	35.02
Zirconia	31.14
Thép không gỉ	35.59
Titanium	28.39
Vàng	19.71
Composite	28.73

†Dữ liệu được lưu trữ tại BISCO, Inc.
Sử dụng Universal Primer ở chế độ tự trùng hợp và Duo-Link Universal ở chế độ quang trùng hợp, theo phương pháp jig của Ultradent.



Chuẩn bị phục hình trực tiếp và gián tiếp

Khuyến cáo sử dụng đề cao su cho tất cả các phục hồi trực tiếp và các chỉ định khác khi có nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bước 1 Chọn kỹ thuật từ A-C



Kỹ thuật A



Kỹ thuật B



Kỹ thuật C

Sản phẩm nổi bật
Select HV® Etch

KỸ THUẬT TỰ ETCHING:

Chuẩn bị xoang trám. Rửa sạch kỹ lưỡng bằng vôi xít nước. Sử dụng viên bóng thấm hoặc hút nước mạnh trong 1-2 giây để loại bỏ nước thừa (không làm khô quá mức).

KỸ THUẬT ETCHING TOÀN PHẦN:

Chuẩn bị xoang trám. Rửa sạch kỹ lưỡng bằng vôi xít nước. Acid Etch men răng và ngà răng bằng etching trong 15 giây. Rửa sạch kỹ lưỡng. Sử dụng viên bóng thấm hoặc hút nước mạnh trong 1-2 giây để loại bỏ nước thừa (để lại bề mặt xoang trám ẩm ướt).

KỸ THUẬT ETCHING CHỌN LỌC:

Chuẩn bị xoang trám. Rửa sạch kỹ lưỡng bằng vôi xít nước. Bơm Etching lên men răng đã mài và chưa mài. Etching tại chỗ trong 15 giây. Sử dụng hút nước mạnh để loại bỏ acid. Rửa sạch kỹ lưỡng. Sử dụng viên bóng thấm hoặc hút nước mạnh trong 1-2 giây để loại bỏ nước thừa (không làm khô quá mức).

Bước 2



Nhỏ 1 lượng bằng nhau của UNIVERSAL PRIMER Phần A & B (tỷ lệ 1:1) vào một khay trộn sạch. Sử dụng cọ, trộn chất kết dính trong 5 giây. Bôi hai lớp UNIVERSAL PRIMER riêng biệt, thoa trên bề mặt răng bằng cọ micro-brush trong 10-15 giây mỗi lớp. Không chiếu đèn quang trùng hợp giữa các lớp.

Bước 3



Làm bay hơi dung môi thừa bằng cách thổi khô bằng vôi khí trong ít nhất 10 giây; không được có sự di chuyển rõ ràng của chất kết dính. Bề mặt phải có vẻ ngoài bóng đều; nếu không, bôi thêm một lớp UNIVERSAL PRIMER và thổi khô.

Bước 4



Phục hồi gián tiếp: Không yêu cầu quang trùng hợp. Tiến hành gắn phục hình.

Sản Phẩm Nổi Bật

SELECT HV ETCH

SELECT HV ETCH của BISCO là acid Phosphoric 35% có độ nhớt cao, được thiết kế cho kỹ thuật "Etching chọn lọc" hoặc "lai" - Etching bờ men mà không Etching ngà răng. Nó cũng có thể được sử dụng cho các quy trình phục hồi Etching toàn phần thông thường. SELECT HV ETCH nhằm tối ưu hóa thao tác và sự chính xác trong điều trị.

- Độ nhớt cao, lý tưởng cho việc Etching men răng.
- Có sẵn trong ống tiêm lớn tiện lợi.
- Dễ dàng rửa sạch mà không để lại cặn.

SELECT HV ETCH có BAC không có sẵn ở tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương của bạn để biết tình trạng sản phẩm.

